

LASER X



单模光器件耦合机

产品特性

标准机型	单Lens耦合, 双Lens耦合, 单FA耦合, 双FA耦合
可以满足以下封装类型和不同封装工艺类型	BOX, COB, 陶瓷基板, SIOB, PLC芯片, 硅光芯片, COC To PIC, SIOB, COC To FA, COC To Collimator, V-groove
可以满足以下类型产品的耦合生产需求	CWDM, DR系列, FR系列, 光引擎, LR4, ER4, SOA (半导体光放大器), 可调激光器、相干类产品、激光传感器, RGB激光产品
可以满足以下元器件的耦合需求	透镜, 透镜阵列, 棱镜, FA, BLOCK, 光纤, MUX, DMUX, 准直器, 适配器, SIOB, COC, PIC
设备特点	搭配了高精度图像辅助定位系统, 有效提高了生产效率和产品质量
	搭配了高精度纳米级别的运动滑台(位置重复精度 $\pm 50\text{nm}$), 可以满足不同类型产品生产需求, 最大限度地减少客户在产品更新换代时重复设备投资的浪费
	模块化设计, 可以根据客户需求快速组合出最佳方案的设备
	同步耦合系统, 有效提高了复杂光路多器件耦合生产效率和产品质量
	自动校准系统, 有效降低了对调试工程师和生产工人的要求
	客户可以自由实现不同类型产品和不同耦合工艺的生产, 能有效减少新产品研发周期和投资
	分级权限管理软件, 能有效控制管理生产设定参数和工艺及保密需求
	可以为客户提供定制化特定功能和自动上下料功能, 可以让设备实现最佳的方案和最高性价比